

電子顕微鏡を用いた最近の鉄鋼材料評価法 —集束イオンビーム加工装置の適用—^{*1}

石川 伸^{*2} 太田 裕樹^{*3} 星 亨^{*2}

New Technique for Steel Characterization by Electron Microscope —Application of Focused Ion Beam Fabrication Technique—

Shin Ishikawa Hiroki Ota Toru Hoshi

1 はじめに

透過型電子顕微鏡(TEM: transmission electron microscope)は、従来より材料評価に重要な役割を果たしてきた。最近では、電界放射型の電子銃を搭載したTEMが登場し、これを用いることによってnm領域での構造解析や組成分析が可能となった。そのためTEMの重要性がますます増している。さらに、微細組織の制御による鉄鋼材料特性の向上とともに、従来は観察の困難であった異種物質界面、あるいは材料中の特定の微小領域の観察に対する要求が一層高まっている。

これらの要求に応えるための最新の手法の一つに、集束イオンビーム(FIB: focused ion beam)加工装置があげられる。この装置はGaイオン照射によるスパッタリングによって微細加工を行うもので、最小ビーム径、ビーム強度などの性能が向上したことによりTEM用薄膜試料作製へと適用範囲が拡大した^{1,2)}。この手法を従来の代表的な薄膜作製法である電解研磨法やイオンミリング法と比較すると、FIB加工法は材料中に異相が存在したとしても一様な薄膜が作製できるという特長をもつ。これは、FIB加工法では低角度でイオン照射するので、スパッタリング速度の影響を受けないで薄膜化されるためである。もう一つの利点は、イオン照射により生ずる二次電子像を観察しながら試料作製ができることから、特定領域の薄膜化ができることである。当社では1995年に(株)日立製作所製FIB加工装置FB-2000を導入し、種々の鉄鋼材料への適用を図ってきた^{3~6)}。本報では導入装置の概要とその適用例を紹介する。

2 装置の概要

Fig. 1(a)にFIB装置の概略を示す。本装置ではイオン源として液体Gaを用い、加速電圧30kVのイオンビームをサブミクロンまで絞り、試料上を走査しながらスパッタリングを行う。イオンビーム径とビーム電流の選択に関しては、初期の粗加工時には迅速な加工のために大電流ビームを用いる。これに次ぐ仕上げ加工時には微細加工のために直径30nm程度のビームを用いる。Fig. 1(b)に加工時の試料と入射ビームの位置関係とTEM観察の方向を、多層構

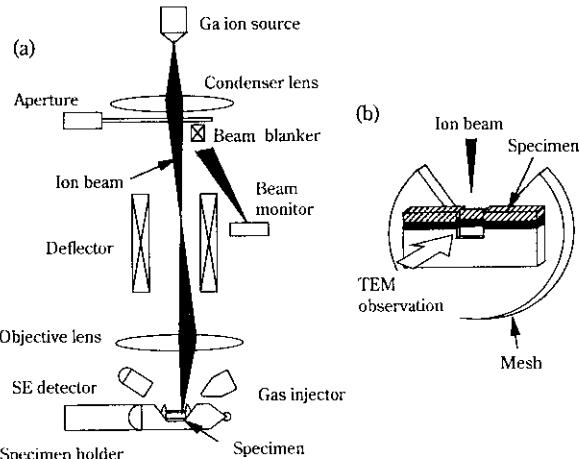


Fig. 1 Schematic illustration of focused ion beam fabrication apparatus (a) and the arrangement of specimen during ion beam fabrication (b)

造をもつ材料の断面試料作製を例にとって示す。あらかじめ数十μmの厚さまで機械研磨された試料を、一部を切り欠いたメッシュに貼り付け、メッシュの切り欠き方向からイオンビームを低角度で照射する。ミクロンオーダーの矩形領域を試料の両面から徐々に除去していく、最終的には電子線が十分透過する0.1μm程度の厚さを残してTEM用試料とする。

試料近傍には二次電子検出器が配置され、試料表面の二次電子像が観察される。この観察に基づいて、加工領域を設定したり、試料形状の変化を観察することができる。二次電子像のみでは作製対象の膜厚を制御することが難しい場合には、FIB加工とTEM観察を交互にくり返して行う。この場合には、FIB加工装置とTEM試料ホルダーを共用とする。また、試料最表層をTEM観察する必要がある場合には、表面をイオンビームから保護するために薄膜化加工に先立って試料表面にW薄膜を蒸着しておくことも可能である。

3 適用例

鋼板上の酸化皮膜あるいはめっき層などの多層から構成される材

*1 平成11年2月12日原稿受付

*2 技術研究所 分析・物性研究部門 主任研究員(掛長)

*3 技術研究所 ステンレス鋼研究部門 主任研究員(掛長)・工博

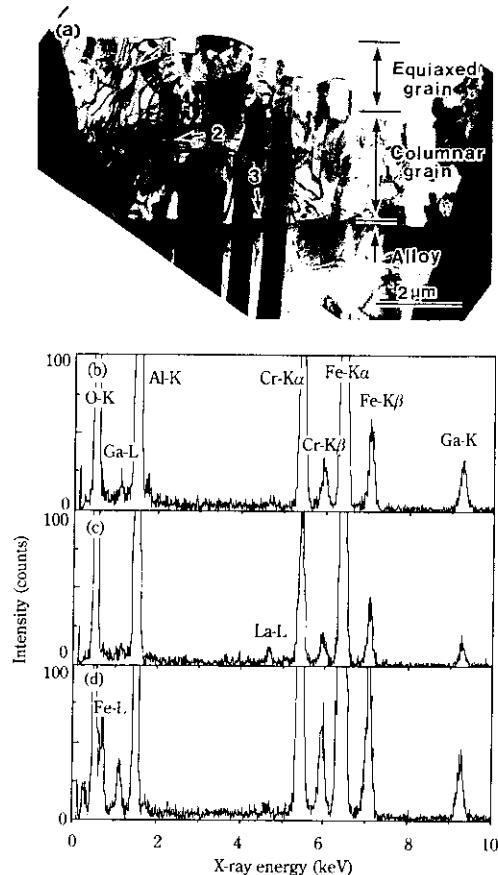


Photo 1 (a) TEM cross-section image of oxide formed on Fe-20Cr-5Al alloy; (b), (c) and (d) EDX spectra obtained at points 1, 2 and 3 in image (a), respectively³

料の断面試料作製には、従来は主にイオンミリング法が用いられてきた。この方法では下地鋼板と皮膜あるいはめっき層でのイオン研磨速度が大きく異なるため、一様な厚さをもつ薄膜を作製することが困難であり、そのため断面組織や界面状態の観察は非常に難しいとされてきた。ここでは、鋼板の断面試料作製においてFIB加工装置の適用が効果的であった3例を紹介する。

3.1 Fe-20Cr-5Al合金酸化皮膜³⁾

自動車の排気ガス浄化触媒の枠体として用いられるFe-20Cr-5Al合金の高温酸化皮膜について、厚さの均一な断面試料を作製するのにFIB加工装置を適用した。この合金は高温で酸化され、合金上にアルミニナ皮膜が形成される。さらにこの合金にLaなどの希土類元素が添加されると、この材料の耐酸化特性が著しく向上する。このときにアルミニナ皮膜中の希土類元素の存在状態を知ることが重要となる。Photo 1 (a)にFIB加工により作製したアルミニナ皮膜／下地合金界面の断面TEM像を示す。アルミニナ皮膜および下地合金がほぼ均一に薄膜化され、皮膜中の組織変化が観察できるのみならず、皮膜／合金界面の状態も明瞭に観察される。Photo 1 (b)～(d)に示すように、界面や粒界の点分析を行なった結果から、微量添加したLaは主にアルミニナ皮膜中の粒界に偏析することが明らかとなった。

3.2 SUS304冷延焼純板の酸化皮膜⁴⁾

次の例は、FIB加工前にW蒸着を行い、非常に薄い酸化皮膜の断面試料を作製した場合である。SUS304の冷間圧延焼純板にはサブ

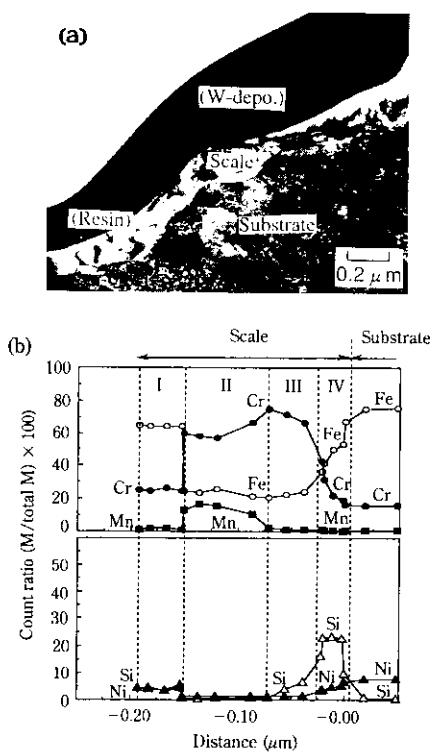


Photo 2 (a): TEM image of the scale on SUS304 annealed at 1373 K. (b): Elemental depth profile of the scale determined by means of energy dispersive X-ray analysis⁴⁾

ミクロンオーダーの酸化皮膜(scale)が形成される。酸化皮膜の厚さや構造が、引き続き行われる脱スケールに影響を与えると考えられているので、酸化皮膜の微細構造の観察が重要である。FIB加工により作製した酸化皮膜の断面TEM像をPhoto 2 (a)に示す。酸化皮膜の厚みは約0.2μmであり、TEM像のみからその微細構造を確認することは難しい。特性X線分析による組成分析を行なった結果、Photo 2 (b)に示すように皮膜は4層構造(I～IV)を有することが分かる。第I層にはFe、Si、第II層にはCr、Mn、第III層にはCr、そして第IV層にはSiが濃化していることが明確に示された。

3.3 すずめっき鋼板の断面組織⁵⁾

第3番目の例は層状構造を有するめっき鋼板の断面組織の観察にFIB加工法がうまく適用された場合である。溶接管用すずめっき鋼板は、Niめっき後連続焼純によりNi拡散層を形成させた鋼板上にすずめっきを施し、さらに通電加熱により表面すず層を融点以上に加熱し(リフロー処理)、島状すずを形成させることにより製造される。Photo 3にFIB加工法により作製したすずめっき鋼板断面試料のTEM像を示す。断面組織は島状の金属すず層(Sn)、母材鋼板(Steel)、およびそれらの界面に存在する(Fe, Ni)Sn₂合金層(Alloy)からなる層状構造をもつ。さらに特性X線分析によりNi拡散層の存在も確認できた。

4 おわりに

FIB加工装置の導入により、様々な形態をもった異種物質界面の断面構造のTEM観察が可能となった。ここで紹介した例に加えて、ミクロンオーダーの粉体試料の薄膜化、圧延ロール・軸受鋼中の炭

Photo 3 TEM image of the low tin plated steel sheet after flow-brightening treatment⁵⁾

化物の薄膜化、さらに多種の鉄鋼材料の特定位置の観察などに適用されている。TEMによる微細構造観察および微小領域分析では、薄膜試料の質が観察結果に決定的な影響を及ぼす。良質な薄膜試料

を作製するために、FIB加工法の適用範囲はこれまでにも増して拡大していくものと期待される。

参考文献

- 1) T. Ishitani, H. Hirose, and T. Kamino : Hitachi Instrument News 26th Electron Microscopy Edition, (1994), 24
- 2) 黒田光太郎, 坂 公恭: までりあ, 34(1995)6, 769
- 3) 石川 伸, 河野雅昭, 前田千寿子, 石井和秀, 下村順一, 吉岡啓一: 日本国金属学会誌, 60(1996)5, 463
- 4) 福田國夫, 宇城 工, 佐藤 進, 太田裕樹: 鉄と鋼, 84(1998)5, 345
- 5) 太田裕樹, 稲永章子, 吉岡啓一: 材料とプロセス, 10(1997)3, 701
- 6) 前田千寿子, 星 亨, 松島朋裕, 下村順一, 磯部 誠, 佐藤昭一: 材料とプロセス, 8(1995)4, 992